

中国半导体材料装备 行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国半导体材料装备 行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202603/785030.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

一、行业相关概述

半导体材料是一类具有半导体性能、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。半导体材料是半导体产业链上游的重要组成部分，在集成电路、分立器件等半导体产品生产制造过程中起关键作用。

第三代半导体材料是继以硅(Si)和砷化镓(GaAs)为代表的第一代和第二代半导体材料之后，迅速发展起来的宽禁带半导体材料。具体是指 E_g (带隙宽度) $2.3eV$ 的宽禁带半导体材料，主要包括碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)，主要应用于新能源车、光伏、风电、5G通信等领域。从现阶段发展来看，GaN材料更适合1000V以下电压等级、高开关频率的器件;相比之下，SiC材料及器件能用在10kV以下应用场景，更适合制作高压大功率电力电子装置，且目前SiC功率器件商业化落地速度极快。

集成电路制造设备泛指用于加工、制造各类集成电路产品所需的专用设备，属于集成电路产业链上游支撑环节。集成电路制造设备投资一般占集成电路制造领域资本性支出的70%-80%，且随着工艺制程的提升，设备投资占比也将相应提高---当集成电路制程达到16及14纳米时，设备投资占比可达85%。

按照工艺流程，集成电路制造设备通常可分为前道工艺设备（芯片制造）和后道工艺设备（芯片封装测试）两大类。其中，前道芯片制造主要包括六大工艺步骤，分别为：热处理（Thermal Process）、光刻（Photo-lithography）、刻蚀（Etch）、离子注入（Ion Implant）、薄膜沉积（Deposition）、机械抛光（CMP），所对应的专用设备主要包括快速热处理（RTP）/氧化/扩散设备、光刻设备、刻蚀/去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备等。后道封装测试工序和相应设备包括减薄、划片、测试、分选等。

二、行业市场规模现状

随着“碳达峰、碳中和”战略的推进实施，绿色、低碳、清洁能源等技术将加速应用，第三代半导体材料装备作为实现高效电能转换技术的重要支撑获得快速发展。

中国半导体材料装备行业在2023年经历终端需求缩减、市场规模下滑的态势后，2024年整体呈现恢复增长态势，与全球半导体材料行业的发展趋势基本一致。截止2025年，我国半导体材料装备市场规模达到4678亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

当前来看，我国半导体材料装备行业细分市场主要分为两大类，分别为半导体材料市场和半导体设备市场，半导体设备市场在2025年的细分市场份额为75.5%，半导体材料细分市场份额为24.5%。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

1、半导体设备

半导体设备市场与半导体产业景气状况紧密相关，其中芯片制造设备是半导体设备行业需求最大的领域。

随着下游5G通信、计算机、消费电子、网络通信等行业需求的稳步增长，以及物联网、人工智能、汽车电子、智能手机、智能穿戴、云计算、大数据和安防电子等新兴领域的快速发展，集成电路产业面临着新型芯片或先进工艺的产能扩张需求，为中国半导体设备行业带来广阔的市场空间。

近年来，中央及地方政府对半导体行业给予了高度重视和大力支持，出台了一系列扶持政策，相关政策和法规为半导体及行业及专用设备行业提供了资金、税收、技术和人才等多方面的有力支持，为国产半导体设备企业营造了良好的经营环境，大力促进了国内半导体及其专用设备产业发展，提升国产半导体设备企业的竞争力。

目前，半导体设备投资市场火热，近几年一直维持在较高水平。IT桔子数据显示，2025年前三季度，半导体设备已披露投资事件共58起，已披露融资金额约41.84亿元。

随着人工智能（AI）与高性能计算（HPC）需求的爆发，先进封装技术成为提升芯片性能的关键路径。

近年来我国半导体设备行业市场规模保持较快速度增长，2025年行业市场规模已经达到3531亿元。具体如下：

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202603/785030.html>